（上接B98版）

单位：千美元

项目	2014年9月末	2013年末	2012年末
流动资产			
货币资金	115,609	129,136	170,558
短期定期存款	61,987	42,042	39,601
应收账款	229,728	238,441	258,043
其他应收款	33,785	15,239	20,726
存货	77,888	71,055	90,203
预付费用以及其他流动资产	24,189	18,970	24,559
流动资产合计	543,186	514,883	603,690
非流动资产			
长期定期存款	425	11,604	489
固定资产净值	1,668,817	1,431,247	1,242,950
无形资产	34,599	35,117	36,361
商誉	381,487	381,487	381,487
递延所得税资产	185	186	–
预付费用以及其他非流动资产	3,405	3,146	3,299
非流动资产合计	2,088,918	1,862,787	1,664,586
资产总计	2,632,104	2,377,670	2,268,276

资料来源：目标公司定期报告

2、固定资产

截至2014年6月末，目标公司固定资产账面净值158,689.7万美元，主要包括自有土地、土地使用权、房屋建筑、机械及电子设备以及其他设备。目标公司固定资产明细如下表所示：

单位：千美元

项目	2012年末	2013年末	2014年6月末
原值：			
自有土地	9,946	9,738	9,738
土地使用权	19,864	19,864	19,864
房屋建筑、在建工程、机械及电子设备	362,227	433,589	513,684
设备	2,915,156	3,139,803	3,327,063
小计	3,307,193	3,602,994	3,870,349
减：累计折旧	2,064,243	2,171,747	2,283,452
固定资产净值	1,242,950	1,431,247	1,586,897

资料来源：目标公司定期报告及管理层提供数据（目标公司未提供截至2014年9月末的数据）

截至2014年6月末，目标公司总部及各子公司土地、房屋建筑（含在建工程和机械及电子设备）账面价值情况如下：

单位：千美元

项目	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值
自有土地（所在地）			
STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation（台湾）	6,504	–	6,504
STATS ChipPAC Korea Ltd.（韩国）	3,234	–	3,234
合计	9,738	–	9,738
土地使用权（所在地）			
STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd（上海）	4,042	1,631	2,411
STATS ChipPAC Malaysia Sdn. Bhd.（马来西亚）	15,822	7,889	7,933
合计	19,864	9,520	10,344
房屋建筑、在建工程、机械及电子设备（所在地）			
STATS ChipPAC Limted.（新加坡）	170,754	71,436	99,318
STATS ChipPAC Korea Ltd.（韩国）	127,737	19,046	108,691
STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd（上海）	133,629	40,339	93,290
STATS ChipPAC Malaysia Sdn. Bhd.（马来西亚）	28,752	25,133	3,619
STATS ChipPAC, Inc.（美国）	4,148	4,063	85
STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd（台湾）	20,339	10,321	10,018
STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation（台湾）	28,325	20,206	8,119
合计	513,684	190,544	323,140

资料来源：目标公司管理层提供

上述资产中，自有土地及土地使用权的相关信息如下：

不动产地址	所有权情况	面积（平方英尺）	用途
No. 176–5, 6 Lin, Hualung Chun, Chiung Lin, 307 Hsin–Chiu Hsien, Taiwan	自有土地	224,879	半导体测试服务、研发、仓储服务以及直达货运服务
342–1 Gakpyong–Ri, Majang–Myeon, Icheon Si, Gyeonggi Province, Korea	自有土地	212,143	半导体封装测试服务、研发、仓储服务以及直达货运服务
中国青浦区华徐公路188号	土地使用权	983,276	半导体封装、仓储装卸及测试、仓储服务以及直达货运服务
73 Lorong Enggang, Ulu Klang Free Trade Zone 54200 Kuala Lumpur	土地使用权	488,448	半导体封装及测试、仓储服务以及直达货运服务

资料来源：目标公司管理层提供

此外，目标公司在新加坡、韩国、马来西亚和美国有不动产租赁，其中目标公司位于新加坡的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）*	开始日	到期日
5 Yishun Street 23, Singapore 768442	租赁	1996年3月1日	2026年3月1日
	许可	1996年3月1日	2026年3月1日
2 Woodlands Sector 1, #01–20, Singapore 738068	租赁	2014年10月23日	2017年10月22日
	许可	2014年10月23日	2017年10月22日
10 Ang Mo Kio Street 65, #15–17/20, Singapore 569059	租赁	2012年1月1日	2014年12月31日

*注：此处租赁是指对土地、厂房的租赁，许可是指该处物业被许可用作工业用途；10 Ang Mo Kio Street 65, #15–17/20, Singapore 569059 不涉及工业用途，故无对应许可。

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于韩国的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）	出租方	开始日	到期日
Gonghang–dong–ro, Jung–gu, Incheon Metropoitan City	租赁	Incheon Int'l Airport Corp.	2013年5月16日	2063年5月15日
Part of Gyeongchung–dae–ro 2091, Bubal Eup, Icheon–si, Gyeonggi–do	租赁	Hydis Technologies Co., Ltd.	2013年11月1日	2017年10月31日
1F(part) and 5F, Ami–ri San 136–1, Bubal Eup, Icheon–si, Gyeonggi–do	租赁	Hydis Technologies Co., Ltd.	2014年5月1日	2017年10月31日
Ami–ri San 136–1, Bubal Eup, Icheon–si, Gyeonggi–do	租赁	SK Hynix Inc.	2005年7月1日	2015年6月31日
Part of Gyeongchung–dae–ro 2091, Bubal Eup, Icheon–si, Gyeonggi–do	租赁	SK Hynix Inc.	2014年1月1日	2014年12月31日

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于马来西亚的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地*	合同（租赁/许可）
PN 7128, Lot 7716, Mukim Ulu Kelang, Gombak, Selangor	租赁
HS (M) 2601, Lot 7666, Mukim Ulu Kelang, Gombak, Selangor	租赁

*注：马来西亚租赁性产权（leasehold）租赁期为99年，目标公司两处不动产属于租赁性产权，距到期日仍有较长时间。

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于美国的不动产租赁具体情况如下图所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）	出租方	开始日	到期日
46429 Landing Parkway, Fremont, Alameda, 94538	租赁	Fremont Ventures , LLC	2014年4月1日	2020年3月31日
Suite 117, 1711 West Greentree Drive in Tempe, Arizona, 85284	租赁	Agave Property Center, LLC	2013年3月1日	2018年8月31日
9710 Scranton Road, Suite 360, San Diego, 92121	租赁	AZNL–Centrewest, LLC	2014年2月1日	2017年3月31日
5316 Highway 290 West, Suite 320 Austin, Texas 78735	租赁	Goldstar Investments LTD. & LTM Investments L.P.	2012年7月1日	2015年7月31日

资料来源：目标公司管理层提供

3、无形资产

目标公司将与并购、开发或购买专利权和用于经营的技术专利相关的直接支出资本化，形成无形资产原值。截至2012年年末，2013年年末及2014年6月末，目标公司无形资产账面净值分别为3,636.1万美元、3,511.7万美元、3,479.9万美元。目标公司截至2013年末的无形资产明细表如下表所示：

单位：千美元

	2012年末			2013年末			2014年6月末		
	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值
专利、软件及其他	63,430	32,136	31,294	68,814	35,564	33,250	84,184	49,652	34,532
客户关系	99,300	99,300	–	99,300	99,300	–	99,300	99,300	–
技术及知识产权	32,000	26,933	5,067	32,000	30,133	1,867	32,000	31,733	267
商标	7,700	7,700	–	7,700	7,700	–	7,700	7,700	–
合计	202,430	166,069	36,361	207,814	172,697	35,117	223,184	188,385	34,799

资料来源：目标公司定期报告及管理层提供数据（目标公司未提供截至2014年9月末的数据）

4、商誉

目标公司的商誉来源于2001年收购STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation及2004年收购ChipPAC, Inc.，并分别于2011年及2012年对涉及泰国及马来西亚的商誉计提了2,450万美元及2,410万美元减值准备。由于目标公司于2013年开始进行业务重组，逐步将不同地区工厂的同类生产线进行合并，因此目标公司于2013年改变了分地区进行商誉减值测试的方法，变更为将全部地区视为单一业务部门（全套半导体芯片委外封装及测试服务）整体进行减值测试。目标公司历史结算日商誉明细如下表所示：

千美元	2012年末	2013年末	2014年6月末
韩国	247,747	381,487	381,487
中国	70,305		
马来西亚	53,114		
台湾	1,321		
合计	381,487		

资料来源：目标公司管理层提供

（二）主要负债情况

截至2014年9月28日，目标公司总负债168,813.4万美元，其中流动负债为56,159.8万美元，非流动负债为112,653.6万美元。具体构成如下：

单位：千美元

项目	2014年9月末	2013年末	2012年末
流动负债			
应付账款及其他应付款	185,181	138,004	164,301
应付固定资产相关款项	183,681	141,998	42,746
预提费用	105,189	124,640	113,476
应交所得税	14,518	18,207	13,155
短期借款	73,000	37,947	50,690
应付关联方款项	29	100	28
流动负债合计	561,598	460,896	384,396
非流动负债			
长期借款	1,064,314	874,281	792,609
递延所得税负债	46,559	47,476	47,141
其他非流动负债	15,663	24,228	21,532
非流动负债合计	1,126,536	945,985	861,282
负债总计	1,688,134	1,406,881	1,245,678

资料来源：目标公司定期报告

目标公司的非流动负债中包括已发行的总计8.11亿美元的优先票据，其中包括将于2016年到期的2亿美元优先票据，票面利率为5.375%；以及将于2018年到期的6.11亿美元优先票据，票面利率为4.5%。

考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。截至本报告书摘要出具之日，长电科技已经为可能发生的相关票据提前赎回或贷款提前偿还进行了债务重组安排，长电科技已与星展银行就债务重组安排签署了委任函，星展银行将通过向目标公司提供上限为8.9亿美元的过桥贷款对目标公司进行债务重组，该过桥贷款额度将足够覆盖目标公司全部的债务重组需求，后续星展银行将通过退出贷款及协助目标公司发行债券的方式进一步对目标公司的债务进行替换。

七、目标公司最近三年未受到行政处罚或刑事处罚

目标公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未涉嫌违法违规被中国证监会或新加坡证券交易所或新加坡证券业协会立案调查；最近三年未受到行政处罚或刑事处罚。

八、目标公司担保抵押、财务承诺与诉讼情况

（一）目标公司对外担保和抵押情况

截至本报告书摘要签署日，目标公司无对外担保或抵押。

（一）目标公司重大财务承诺情况

截至2014年6月末，目标公司的合同承诺义务金额约为5.55亿美元，具体汇总情况如下表所示：

单位：千美元

	1年以内	1至3年	3至5年	5年以上	合计
资本性承诺	246,943	–	–	–	246,943
经营租赁承诺	36,744	19,285	12,644	94,547	163,220
原材料采购承诺	124,211	–	–	–	124,211
专利权及许可权承诺	4,349	8,698	7,634	–	20,681
合计	412,247	27,983	20,278	94,547	555,055

资料来源：目标公司管理层提供

1、资本性承诺

上述资本性承诺中，约有1.18亿美元与韩国工厂搬迁及新工厂的建设相关。

2、经营租赁承诺

目标公司在新加坡、韩国及美国签订了生产及办公场所的租赁合同，同时在韩国、马来西亚和中国签订了土地租赁合同。经营租赁承诺中，大部分与在建的韩国新工厂租赁的土地及机器设备相关，一年以内、一至三年、三至五年以及五年以上相应的金额约分别为430万美元、1,030万美元、1,030万美元以及8,960万美元。

3、原材料采购承诺

目标公司与部分供应商签订无条件的原材料采购合同，通常这些无条件采购合同期限都在一年以内。

4、专利权及许可权承诺

目标公司签订了一系列专利权许可合同。

（三）目标公司诉讼情况

1、目标公司与Tessera Inc.的诉讼情况

2006年2月，Tessera Inc.（简称"Tessera"）起诉目标公司侵犯其专利权。目标公司于2013年1月与对方签订了和解协议，结束了两者之间的专利诉讼。Tessera同意授予目标公司为期5年的半导体封装技术专利权使用许可。

2、目标公司与U–Freight Singapore Pte Ltd的诉讼情况

2013年，目标公司指控由U–Freight Singapore Pte Ltd（简称"U–Freight"）运输的设备造成损坏，并要求赔偿204,319新加坡元。目标公司已经从相关保险获得补偿，并正在帮助保险公司起诉U–Freight。截至2014年6月末，被告还未做出任何反诉。

3、目标公司与ERS electronic GMBH的诉讼情况

2014年10月7日，目标公司发布公告称，德国企业ERS Electronic GMBH（简称"ERS"）指控目标公司的两台焊接机侵犯了该企业的专利权。关于此次诉讼的预审会议于2014年11月26日召开，目标公司已经聘请了辩护律师应对此次诉讼。此诉讼将于2015年1月28日再次召开预审会议。

九、目标公司持续经营活动

（一）业务概况

目标公司是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。依托现有的在倒装芯片、晶元、3D封装等方面的技术优势，目标公司为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。

目标公司总部位于新加坡，主要收入来源为美国，2013年美国的收入占总收入的69.2%，亚洲地区收入占19.0%，欧洲地区收入占11.8%。2013年目标公司封装收入占总收入的77.7%，其中先进封装占总收入的46.9%，焊线接合封装占总收入的30.8%，另外22.3%来自测试收入。

2012年，目标公司实现总收入17.02亿美元，同比下滑0.3%；2013年，目标公司实现总收入15.99亿美元，同比下滑6.1%；2014年前三季度，目标公司实现总收入11.79亿美元，同比下滑2.0%。从目标公司层面看，一方面是受高端智能手机、个人电脑等终端市场需求增速放缓的影响，另一方面是由于半导体封装行业逐步由焊线封装转向先进封装，对目标公司焊线封装业务进一步造成冲击。另外，从外部大环境看，全球半导体产业整体增速放缓，产业结构面临调整，产能在区域上重新进行分配，也对目标公司经营产生负面影响。

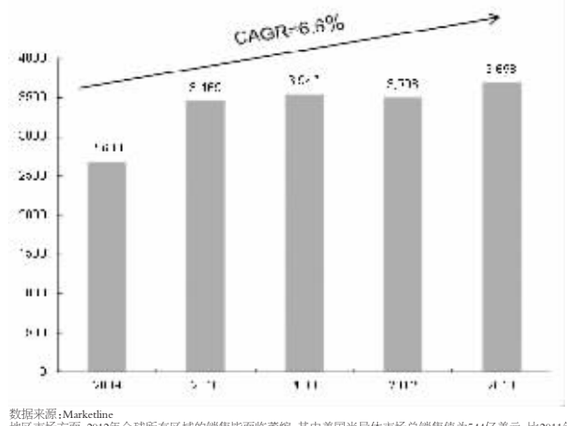
2012年、2013年、2014年前三季度，目标公司分别实现毛利2.88亿美元、2.18亿美元、1.34亿美元。目标公司毛利率由2012年的16.9%降至2013年的13.6%，主要原因是生产设备开工不足，产能利用率由2012年的75%下降至2013年的66%，从而导致折旧摊销等固定成本较高。

（二）集成电路封测行业概况

1、半导体行业概况

1）世界半导体产业开始复苏

全球半导体产业在经济危机造成的全球经济继续低迷中渡过了2012年，全球半导体产业规模约为3,508亿美元，较2011年的3,547亿美元减少1.1%。经过2012年的低谷后，全球半导体行业在2013年开始进入复苏，产业规模回升到3,698亿美元，较2012年有5.4%的增幅。总体来说，世界半导体产业稳定增长，2009年到2013年CAGR达到6.6%。2009年至2013年世界半导体销售额情况如下图所示：



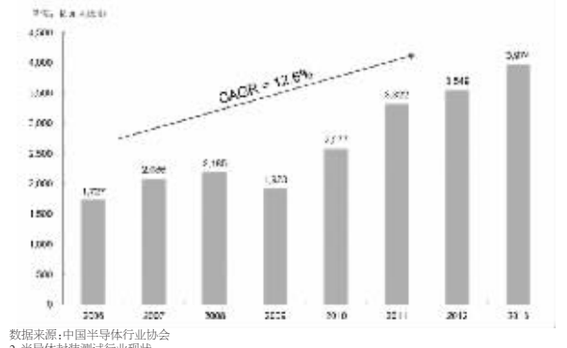
数据来源：Marketline

地区市场方面，2012年全球所有区域的销售皆面临萎缩，其中美国半导体市场总销售值为544亿美元，比2011年下降了1.5%；日本半导体市场销售值为411亿美元，比2011年下降了4.3%；欧洲半导体市场销售值为332亿美元，比2011年下降了11.3%；亚洲区半导体市场销售值为1,630亿美元，比2011年下降了0.6%。

2013年美国半导体市场总销售额回升到696亿美元，欧洲销售额达到380亿美元，亚洲升幅最大，增长52%，于2013年达到2,481亿美元。

2）中国半导体行业不断增长，需求旺盛

国外半导体市场增幅放缓，但中国半导体市场表现出强健的抗风险能力和旺盛的市场需求。2013年全年中国半导体产业规模为3,974亿元，同比增长12.0%，2006年到2013年，8年内CAGR达到12.6%，明显高于全球半导体市场增速。2006年至2013年中国半导体产业规模情况如下图所示：



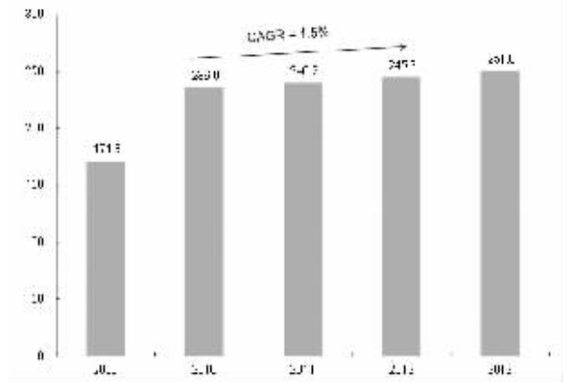
数据来源：中国半导体行业协会

2、半导体封装测试行业现状

半导体行业产业链自上而下分为芯片设计、晶圆代工、封装测试以及下游需求四个环节。设计公司研发人员首先完成芯片的寄存器级的逻辑设计和晶体管级的物理设计，验证通过的电路版图交付给代工厂；晶圆代工厂专门从事半导体晶圆制造生产，接受IC 设计公司委托制造，自身不从事设计，其产品是包含成百上千颗晶粒（每颗晶粒就是一片IC）的晶圆；接着，封装厂通过多道封装工序引出晶粒I/O 焊盘上的电子信号并制作引脚/焊球，实现芯片与外界的电气互连；测试环节是IC 制造的最后一步，作用是验证IC 是否能按设计功能正常工作，位于产业链下游。

1）世界半导体封装测试行业增长放缓

从全球角度来看，2012年除中国外的整体封测产能都在收缩，全球半导体封测市场需求低迷，到2013年有所回升。2013年，全球半导体封测市场总收入251亿美元，较2012年增长2.3%。在经历了2009年到2010年的大幅上升后，2010年到2012年3年CAGR仅为1.5%。2009年至2013年世界半导体封测业增长状况如下图所示：



数据来源：Gartner（单位：亿美元）

目前，在集成电路封装测试行业，高端技术和高端产品的市场份额仍然由国际巨头占据，如台湾日月光（ASE）、美国安科（Amkor）、台湾矽品（SPIL）、星科金朋（STATS）等世界大封装企业。

2013年，全球半导体封测市场总收入251亿美元，较2012年增长2.3%。日月光营业收入占比仍然居第一位，长电科技已进入世界集成电路封测行业第六名，是企业规模唯一进入世界封测行业排名前十的中国大陆封测企业。全球前十大封装测试公司及其市场份额如下表所示：

公司名称	2013年市场份额（根据营业收入）
日月光	19%
Amkor	12%
矽品	9%
星科金朋	6%
力成科技	5%
长电科技	4%
J–Devices	3%
UTAC	3%
ChipMOS	3%
Chiobond	2%

数据来源：Gartner

2）中国半导体封装测试行业市场需求长期增长，行业景气度高

中国封测行业在半导体行业紧缩周期中逆势扩张，相应2010年到2012年的CAGR达到18.1%，远远高于世界水平的1.5%。2012年中国封测厂房面积总体增长5%，但是全球其他地区的封测厂房面的下降了2%。而中国的封测产能已经占到了世界21%。

中国半导体封装测试行业市场规模主要由四个方面驱动：全球封测产能向中国转移，国内封测技术突破，国内半导体设备国产化需求上升和下游消费电子设备需求的增长。2012年，国内封装测试行业保持了平稳增长，其规模已超过1000亿元，达到1035.67亿元，同比2011年的975.7亿元，增速为6.1%。从国内主要封装测试企业2012年的销售额来看，这些企业大多保持了业绩增长的势头，10大封装测试企业的进入门槛已经达到20亿元人民币的水平。

3）中国国家政策鼓励半导体封装测试行业发展

国家颁布了多项政策积极鼓励和发展半导体封装环节，《信息产业科技发展"十一五规划"和2020年中长期规划纲要》提出重点发展集成电路关键技术，包括 MEMS 技术和新型、高密度集成电路封装测试。2011年工信部和商务部将线宽65nm 以下的芯片封装归入当前优先发展的高技术产业领域；此外，2011年《集成电路产业"十二五"发展规划》指出大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型3D 封装产品进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。

4）集成电路产业下游消费电子设备需求快速增长

国内半导体封装测试行业主要受益于下游消费电子设备需求的不断增长，其中，高端装备制造、智能电网等都需要电子元器件，特别是智能移动终端、LED 照明市场可获得持续增长。

此外，随着移动互联网时代的来临，我国移动智能终端产业发展迅速，市场快速扩大，拥有巨大发展潜力。未来几年内，智能机依然可以保持两位数的增长，平板电脑很大程度上能够弥补PC 需求下滑的影响。同时，全球4G 布局加快，航天探测热潮重启利于工业等领域内半导体市场的发展。

（三）目标公司产品及整体解决方案

目标公司提供半导体封装和测试的综合解决方案，业务按照产品类型主要分为先进封装（Advanced Packaging），焊线接合封装（Wirebond Packaging）和测试服务（Test Services）三块。从终端用户市场看，目标公司业务主要分为通信（Communication），消费者、多应用及其他（Consumer, Multi–applications & Others）以及个人电脑（Personal Computers）。从地域分布来看，目标公司的业务主要在美国、欧洲和亚洲开展。2011年–2013年目标公司业务结构如下：

先进封装（Advanced Packaging）：目标公司使用了包括晶圆凸块、倒装芯片、扇出型晶圆级封装、内嵌式晶圆级凸点封装（eWLB）等在内的先进集成电路封装技术。先进封装业务发展迅速，在目标公司整体收入的比重由2011年的35%提高到2013的47%，在三块业务中占比最高，是目标公司未来发展的重要增长力，主要表现在晶圆级封装在生产中的应用已经趋近成熟并被广泛采用，并且eWLB技术正在吸引越来越多的客户。

焊线封装（Wirebond Packaging）：目标公司使用了包括引线封装、层压封装等在内的焊线集成电路封装技术，2013年焊线封装贡献了目标公司总体收入的31%。

测试（Test Services）：目标公司提供包括晶圆针探、最终测试等在内的服务，特别是在混合信号、射频等电子设备的测试方面实力突出，2013年测试业务贡献目标公司全部收入的22%。

2013年，目标公司先进封装业务的收入同比下降1.4%至7.5亿美元，主要是受无线通信市场封装需求量下降的影响；2013年，目标公司焊线封装业务的收入同比大幅下降17.8%至4.92亿美元，主要是由于个人电脑以及其他电子设备封装需求下降，此外，半导体封装行业的整体发展趋势是由焊线封装转向先进封装，对目标公司的焊线封装业务也产生不利影响；2013年，目标公司测试服务业务表现抢眼，同比逆势增长4.2%至3.56亿美元。2013年，先进封装、焊线封装、测试三者占总营业收入比重分别为47%、31%、22%。最近三个财年目标公司主营收入构成比例如下图所示：

数据来源：目标公司年报

2011–2013年目标公司按产品细分收入情况如下表所示：

百万美元	2011	2012	2013
先进封装	602	761	750
同比增长率	–	26.3%	–1.4%
焊线封装	771	599	492
同比增长率	–	–22.4%	–17.8%
测试	333	342	356
同比增长率	–	2.8%	4.2%

数据来源：目标公司年报

（四）目标公司产品策略

1、先进封装

目标公司牢牢把握住先进封装产品未来广阔的市场前景，在倒装芯片方面，将无线通讯视为可能的新增长点，专注外观尺寸和成本相关的问题，深度开发倒装芯片细间距球栅阵列、超高清等技术。在晶圆级封装技术方面，目标公司主要针对300mm的晶圆，并将扇出型晶圆级封装作为发展重点。

未来，在倒装芯片方面，目标公司将持续推进成本效率，专注于智能手机和平板市场，重点推动与有限网络和消费板块相关的倒装芯片和球栅阵列技术。在晶圆级产品方面，重点发展FlexLine技术流程，推动市场需求并完成产能扩张，目标公司也将持续发展eWLB技术及相关产品。

2、焊线接合封装

在焊线接合封装方面，目标公司主重芯片尺寸封装，包括芯片堆叠细间距球栅阵列封装和方形扁平无引脚封装，专注于扩大目标公司在堆叠晶片领域的领导地位。

目标公司计划在2015年前将焊线接合封装工厂由五家整合至两家，包括将马来西亚工厂迁至中国以及韩国部分业务转移至中国。目标公司将继续推动金线回填、模拟以提高旧型焊线机的利用率，并依据核心客户的需求，适当考虑扩张铜线的产能，专注于智能手机市场。

3、测试服务

在测试服务方面，目标公司专注于泰瑞达平台，以避开内存测试和小众平台，实施先进的IT解决方案，提高效率并降低成本。此外，目标公司还有针对性地增加对纯测试业务的支持，专注于填补未被充分利用的资产。

未来目标公司计划根据选项卡管理增长平台，针对选定的新增纯测试业务，重新为其配置销售和营销团队。

4、目标公司主要产品的质量控制情况

目标公司的质量控制目前为总部统一管理模式，体系完整，且质量控制管理层的从业经验较为丰富。目标公司质量事件报警和追踪，质量管理方面的信息化程度较高。

（五）目标公司市场及销售策略

1、目标市场概述

1）按终端用户市场分类

目标公司为包括移动端、个人电脑等在内的设备提供封装及测试服务，主要的终端市场是手机通信市场，2013年贡献目标公司全部收入的69%，其他电子设备和个人电脑分别贡献收入的23%和8%。2014年第三季度，目标公司收入中66%来自通信市场，8%来自个人电脑市场，剩余26%来自其他电子设备。相比于2013年，目标公司产品终端市场更为分散。

2010—2012年，目标公司在手机通信市场的业务连续增长，2013年智能手机市场分化明显，目标公司之前表现良好的高端智能机需求量下降，而低端智能机市场增长迅速，由于目标公司在低端智能机市场的影响力一般，2013年目标公司在手机通信市场的收入同比下滑5%。

目标公司在个人电脑市场的业务范围主要是磁盘驱动及其他，目标公司磁盘驱动业务收入占整体个人电脑收入的半数以上。此外，由于个人电脑市场销售情况的低迷，对目标公司业绩产生了不利影响。2013年，目标公司在个人电脑市场的收入同比下滑15%。2014年个人电脑业务占总收入比重与上年持平。

2011–2013年不同终端用户市场收入占比情况如下图所示：

数据来源：目标公司年报

2011–2013年按终端用户市场细分收入情况如下表所示：

单位：百万美元

	2011	2012	2013
手机通信	1012	1162	1103
同比增长率	–	14.8%	–5.1%
其他电子设备	471	386	366
同比增长率	–	–18.0%	–5.2%
个人电脑	224	153	129
同比增长率	–	–31.5%	–15.4%

数据来源：目标公司年报

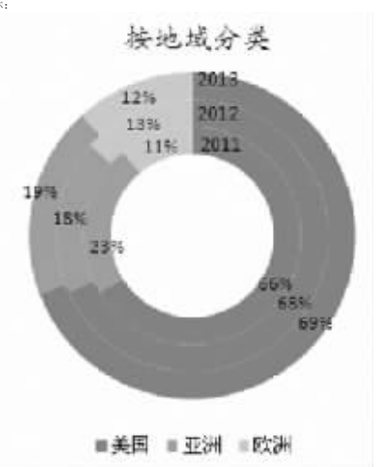
2013年目标公司前五大客户销售额合计7.95亿美元，目标公司总收入的49.7%。

目标公司董事、监事、高级管理人员未在目标公司前五名供应商或客户中占有权益。

2）按地域分类

目标公司的业务主要集中在美国市场。2013年，受市场整体以及目标公司自身经营的影响，目标公司在亚洲、美国市场的收入分别小幅下滑3%和15%，欧洲市场降幅较大，收入同比下滑17%。

目标公司注重开拓新兴市场，在发展中国家的业务实力不断提升，2014第三季度目标公司在亚洲区的收入占总体收入的比重提升到26.6%，较2013年第三季度同比增加7.4%，较2014年第二季度环比回落2.2%。2011–2013年不同地域收入占比情况如下图所示：



数据来源：目标公司年报

2011–2013年按终端细分收入情况如下表所示：

百万美元	2011	2012	2013
美国	1130	1160	1106
同比增长率	–	2.7%	–4.7%
亚洲	387	313	304
同比增长率	–	–19.2%	–3.0%
欧洲	188	228	189
同比增长率	–	21.5%	–17.3%

数据来源：目标公司年报

2、市场销售策略及模式

目标公司客户订单由各业务部门经理负责处理，接到订单后按照相应的封装需求（先进封装、传统封装）向相应工厂分配订单。工厂发货给客户之后，由业务部门负责货款的收取。

目标公司相应的销售部门分布为：4个美国销售部门、1个欧洲销售部门、1个大中华/台湾销售部门、1个韩国销售部门和1个日本销售部门。

（六）目标公司供应链策略及模式

目标公司将供应商分为两大类，分别为生产性供应商和环境供应商。其中生产性供应商指提供目标公司生产过程中所需要的原料、物料、委外加工、设备、工具的供应商；环境供应商指提供目标公司生产活动过程中所产出的废弃物处置的施工商。

1、目标公司供应链运作模式

目标公司供应链运作模式较为成熟，具体由八大策略分工组成，如下表所示：

策略名称	具体措施
开发策略	1. 遵循低成本原则制定集团供应商开发规划 2. 前期实施供应商双重开发 3. 实施中国供应商开发 4. 减轻和降低材料采购（BOM）风险
供应商管理	1. 供应商交期和生产能力在线管理 2. 供应商价格参照 3. 供应商周期性评定 4. 减轻和降低材料采购（BOM）风险 5. 平衡其他成本和费用
谈判策略	1. 结合季度和临时谈判 2. 采用双方报价策略 3. 实施新的商业材料成本管理 4. 替代材料定价策略 5. 关注成本降价趋势 6. 开发低成本供应商
价值工程和最佳BOM策略	1. 开发供应商合作项目 2. 推进新产品设计 3. 协助供应商采用低成本工艺 4. 减少金线的使用和实验 5. 减少金线长径和长度 6. 增加铜线产品 7. 重新设计引线框和基板
SDE策略	1. 开放具有有效成本控制战略的供应商 2. 锁定材料的人厂价格，制定成本的路线图
供应商发展计划	1. 提供供应商在线技术支持 2. 采用新的技术支持
技术开发	1. 寻找低成本材料 2. 发展与战略供应商合作开发项目的杠杆作用
供应商门户策略	1. 提高供应链可见性，促进与供应商的合作 2. 预测需求计划 3. 保证采购订单的执行及确认 4. 提前装运通知 5. 提高供应商能力的可见性 6. 实施供应商WIP状态监控 7. 报价能见度的要求和跟踪

资料来源：目标公司管理层提供

2、 目标公司购买流程

1）材料的采购流程

资料来源：目标公司管理层提供

2）设备的采购流程

资料来源：目标公司管理层提供

（七）目标公司研发情况

目标公司注重提高生产过程的技术含量，重视研究开发，2012年研发费用占目标公司总体收入3.0%，2013年占比2.9%。目标公司洞察性地抓住半导体封装行业未来倾向于先进封装的大趋势，积极开发相关技术，在先进晶圆级封装领域取得显著成果，特别是eWLB技术，目前该技术在移动通信市场应用越来越广泛。

目标公司已经具备了一套完善的研发流程和体系，所有新技术的选取、研发和投入都需要进入流程体系之内进行严格的审阅和管控，并且相应的研发成果都需要上传到专门的信息系统中。在这套研发体系下，目标公司从2010年到2014年发表的技术白皮书数量如下：

技术分类	技术白皮书数量
晶圆级封装技术	29
倒装封装技术	25
3D封装技术	18
铜焊线封装技术	4

资料来源：目标公司管理层提供

同时研发体系也较好地将研发团队与技术市场团队结合到一起，由技术市场部门负责市场需求研究，明确技术需要，研发部门负责研发得到可以满足需求的新技术，并通过内部流程体系完成相关的验证和资料的收集，之后由技术市场部门进行相应的市场推广。

2011–2013年，目标公司研发支出占收入的平均百分比为3%，研发费用及其占收入的百分比情况如下图所示：

资料来源：目标公司定期报告

十、目标公司非持续经营活动

（一）目标公司关闭马来西亚工厂

目标公司于2013年6月宣布关闭马来西亚工厂，计划将马来西亚的封装测试业务整合至中国工厂内，以扩大中国业务运营规模并优化成本结构。目标公司管理层表示，马来西亚业务整合关闭计划于2013年和2014年分几个阶段进行，并将于2014年底前完成。

马来西亚业务的大部分客户已经同意将产品订单转移至目标公司中国工厂，客户关系转移于2014年9月底前全部完成。

目标公司管理层对马来西亚工厂的固定资产可用性进行了分析：对于尚可使用的设备，将全部转移至中国工厂；对于可对外出售的房屋建筑，将出售处置；对于不能使用或不能出售的厂房建筑及设备的账面净值计提减值准备。马来西亚工厂已于2012年和2013年共计